

无锡泰连芯科技有限公司

TLX358A

1.1MHz、精密、轨到轨输入/输出 CMOS 运算放大器

2024 年 12 月

1.1MHz、精密、轨到轨输入/输出 CMOS 运算放大器

1 特性

- 高增益带宽：**1.1MHz**
- 轨到轨输入及轨到轨输出
- 输入失调电压最大值：**±4.5mV**
- 输入电压范围：**-0.1V ~ +5.6V**
(当 **V_s = 5.5V** 时)
- 工作电压范围：**+2.5V ~ +5.5V**
- 最高工作温度：**+125°C**
- 封装：**SOP8、MSOP8**

2 应用

- 传感器
- 光电二极管前置放大器
- 有源滤波器
- 测试设备
- 模数转换驱动

3 概述

TLX358A 运算放大器可以在低电压下工作，采用轨到轨输出架构，拥有卓越的速度/功耗比，提供高带宽 (1.1MHz) 和 0.5V/μs 的压摆率。该运算放大器具有单位增益稳定和超低输入偏置电流的特点。

TLX358A 具有较低的失调电压，在 25°C，V_s = 5V，V_{CM} = V_s/2 时，保证不高于 ±4.5mV。

该器件非常适合传感器接口、有源滤波器和便携式应用。TLX358A 系列运算放大器的工作温度范围为 -55°C 至 +125°C，单电源供电情况下，工作电压为 2.5V 至 5.5V。

质量等级：军温级&企军标

器件信息 (1)

型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TLX358A	SOP8	4.90mm×3.90mm
	MSOP8	3.00mm×3.00mm

(1) 详细的订单型号说明，请参考数据表后的封装选项部分。

目录

1 特性	2
2 应用	2
3 概述	2
4 修订历史	4
5 封装和订单说明⁽¹⁾	5
6 引脚定义和功能	6
7 规格	7
7.1 绝对最大额定参数	7
7.2 ESD 等级	7
7.3 推荐工作条件	8
7.4 典型电气参数	9
7.5 典型参数曲线	11
8 应用与设计	14
8.1 应用注意事项	14
8.2 PCB 布局设计注意事项	14
8.3 仪表放大器	14
8.4 概览	15
9 封装规格尺寸	16
10 包装规格尺寸	18

4 修订历史

注意: 更新前的版本页码可能与当前版本不同。

版本	更新日期	变更项目
A.1	2020/03/23	正式版
A.2	2021/11/10	1. 增加第 11 页图 3. 功能框图 2. 更新 A.1 版本第 2 页包装规格
A.2.1	2024/03/05	修改包装命名
A.3	2024/12/12	1. 在 A.2.1 版本第 5 页添加 MSL 2. 在 A.2.1 版本第 4 页添加结至环境热阻参数 3. 更新包装说明 4. 删除 TLX358AXQ 订单型号

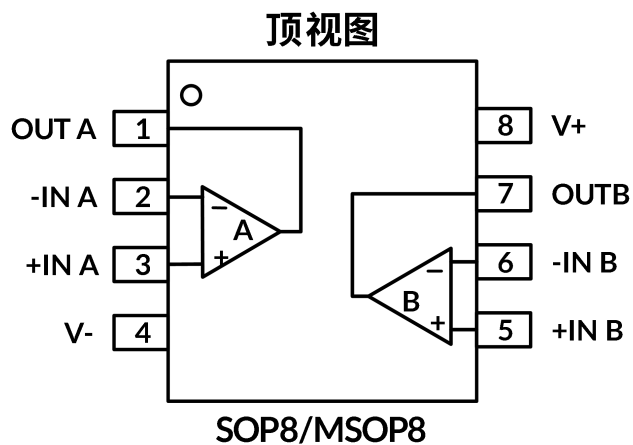
5 封装和订单说明⁽¹⁾

订单型号	封装类型	工作温度(°C)	丝印 ⁽²⁾	MSL ⁽³⁾	质量等级
JTLX358AXK	SOP8	-55°C ~+125°C	TLX358A	MSL3	企军标
JTLX358AXM	MSOP8	-55°C ~+125°C	TLX358A	MSL3	企军标
JTLX358AXK(W)	SOP8	-55°C ~+125°C	TLX358A	MSL3	军温级
JTLX358AXM(W)	MSOP8	-55°C ~+125°C	TLX358A	MSL3	军温级
TLX358AXK	SOP8	-40°C ~+125°C	TLX358A	MSL3	工业级
TLX358AXM	MSOP8	-40°C ~+125°C	TLX358A	MSL3	工业级

注意:

- (1) 该信息是当前版本的最新数据。这些数据如有更新，将及时更新到我司官网，恕不另行通知。
- (2) 丝印可能会有其他附加的代码，用于产品的内控追溯（包括数据代码和供应商代码）或者标志产地。
- (3) TLXIC 装配厂使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键，或者您有特殊要求，请与 TLXIC 技术支持联系。

6 引脚定义和功能



引脚功能

引脚名称	引脚	I/O ⁽¹⁾	功能说明
	SOP8/MSOP8		
-INA	2	I	A 通道反相输入端
+INA	3	I	A 通道同相输入端
-INB	6	I	B 通道反相输入端
+INB	5	I	B 通道同相输入端
OUTA	1	O	A 通道输出
OUTB	7	O	B 通道输出
V-	4	-	负电源（或者低电压）供电脚
V+	8	-	正电源（或者高电压）供电脚

(1) I=输入管脚, O=输出管脚。

7 规格

7.1 绝对最大额定参数

在自然通风温度范围内（除非特别注明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
电压参数	工作电压, $V_S = (V+) - (V-)$			7	V
	输入引脚 ⁽²⁾		(V-)-0.5	(V+) +0.5	
	输出引脚 ⁽³⁾		(V-)-0.5	(V+) +0.5	
电流参数	输入引脚 ⁽²⁾		-10	10	mA
	输出引脚 ⁽³⁾		-140	140	mA
	输出短路电流 ⁽⁴⁾		持续		
θ_{JA}	结至环境热阻 ⁽⁵⁾	SOP8		110	°C/W
		MSOP8		170	
温度参数	自然通风条件下的工作温度范围, T_A		-55	125	°C
	结温, T_J ⁽⁶⁾			150	
	储存温度范围, T_{stg}		-65	150	

- (1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作，超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。
- (2) 输入端口内部设计有对电源轨的钳位保护二极管，当输入信号超过电源轨 0.5V 及以上时，必须限制输入的电流不超过 $\pm 10\text{mA}$ 。
- (3) 输出端口内部设计有对电源轨的钳位保护二极管，当输出信号超过电源轨 0.5V 及以上时，必须限制输出电流不超过 $\pm 140\text{mA}$ 。
- (4) 输出对地短路时会导致过热并对芯片造成永久损坏，故无法测试极限值。
- (5) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。
- (6) 最大功耗是有关 $T_{J(MAX)}$ 、 $R_{\theta JA}$ 和 T_A 的函数。任意环境温度下的最大功耗为 $P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{\theta JA}$ 。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

7.2 ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

			标称值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体模型 (HBM)	± 3000	V
		机械模型 (MM)	± 200	



ESD 灵敏性警告

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格。

7.3 推荐工作条件

在自然通风温度范围内（除非特别注明）

		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压范围, $V_s = (V+) - (V-)$	单电源供电	2.5		5.5	V
	双电源供电	± 1.25		± 2.75	

7.4 典型电气参数

测试条件为: $T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $V_S = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$, 全温⁽⁹⁾ = $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ (除非特别注明)⁽¹⁾

参数		测试条件	T _J	TLX358A			
				最小值 (2)	典型值 (3)	最大值 (2)	单位
供电参数							
V _s	工作电压范围		25°C	2.5		5.5	V
I _Q	每通道静态工作电流		25°C		60	110	μA
PSRR	电源抑制比	V _s =2.5V to 5.5V, V _{CM} =(V-)+0.5V	25°C	74	90		dB
			全温	65			
输入参数							
V _{os}	输入失调电压	V _{CM} =0V to 3.5V	25°C	-4.5	±0.8	4.5	mV
V _{os} T _C	输入失调电压温漂		全温		±2		μV/°C
I _B	输入偏置电流 ^{(4) (5)}		25°C		±10	±100	pA
I _{os}	输入失调电流 ⁽⁴⁾		25°C		±1	±10	pA
V _{CM}	共模输入电压范围	V _s = 5.5V	25°C	-0.1		5.6	V
CMRR	共模抑制比	V _s = 5.5V V _{CM} =-0.1V to 4V	25°C	74	90		dB
			全温	68			
		V _s = 5.5V V _{CM} =-0.1V to 5.6V	25°C	63	80		
			全温	57			
输出参数							
A _{OL}	开环电压增益	R _L =2KΩ Vo=0.15V to 4.85V	25°C	85	105		dB
			全温	80			
		R _L =10KΩ Vo= 0.05V to 4.95V	25°C	88	110		
			全温	83			
	输出距轨电压	R _L =2KΩ	25°C		25		mV
		R _L =10KΩ			8		
I _{OUT}	输出短路电流 ^{(6) (7)}		25°C		130		mA
频率响应参数							
SR	压摆率 ⁽⁸⁾		25°C		0.5		V/μs
GBP	增益带宽积		25°C		1.1		MHz
PM	相位裕度		25°C		64		°
ts	建立时间 0.1%				1.3		μs
	过载恢复时间	V _{IN} ·Gain≥V _s			2.3		μs
噪声参数							
e _n	输入电压噪声密度	f = 1KHz	25°C		22		nV/√Hz
		f = 10KHz	25°C		20		nV/√Hz

注意：

- (1) 该表仅代表指定温度下及工厂测试条件下的产品参数。工厂测试条件下，产品的自热非常有限。
- (2) 极限值是在 25°C 条件下进行的 100% 生产测试。通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保工作温度范围的限制。
- (3) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。
- (4) 该参数由设计和/或特性保证，不需要在生产中进行测试。
- (5) 正电流对应流入产品的电流。
- (6) 最大功耗是有关 $T_{J(MAX)}$ 、 $R_{\theta JA}$ 和 T_A 的函数。任意环境温度下的最大功耗为 $P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{\theta JA}$ 。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。
- (7) 短路实验是瞬时实验。
- (8) 取值为正负转换速率中较慢的值。
- (9) 保证全温度范围。

7.5 典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

测试条件为: $T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $V_S = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, $V_{OUT} = V_S/2$ (除非特别注明)。

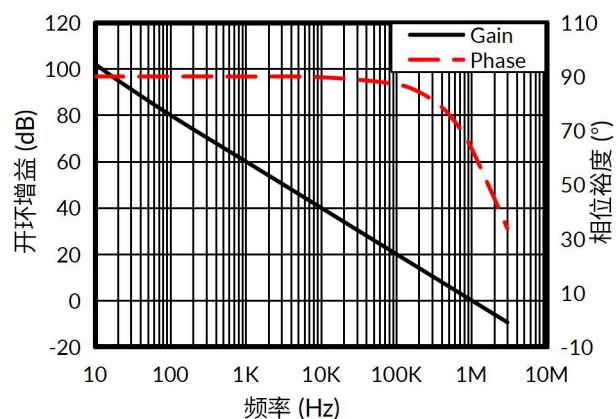


图 1. 开环增益和相位裕度与频率的关系

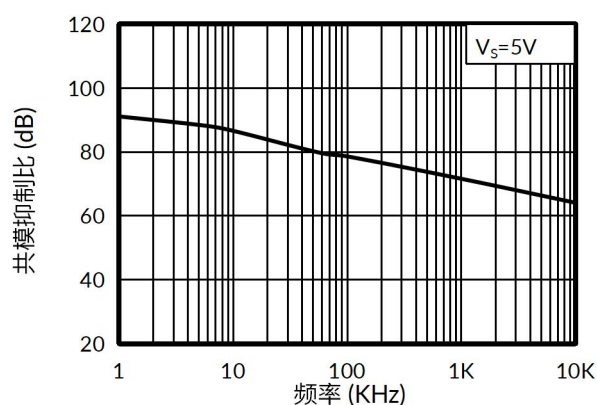


图 2. 共模抑制比与频率的关系

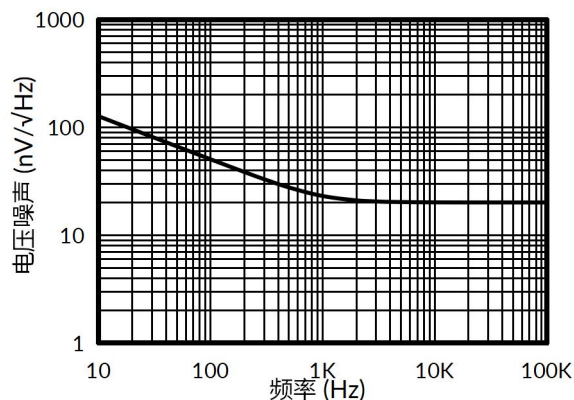


图 3. 输入电压噪声密度与频率的关系

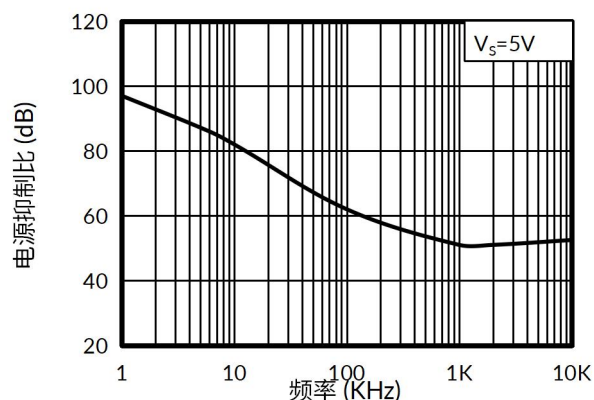


图 4. 电源抑制比与频率的关系

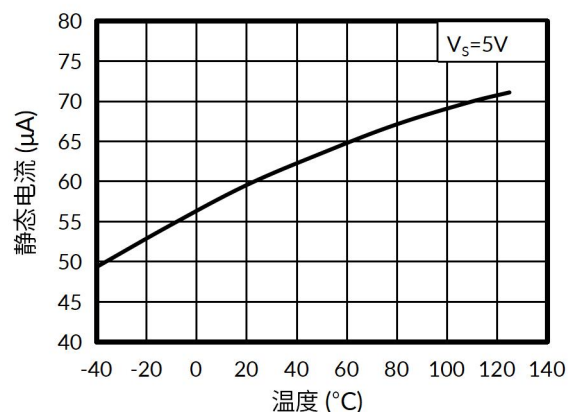


图 5. 静态电流与温度的关系

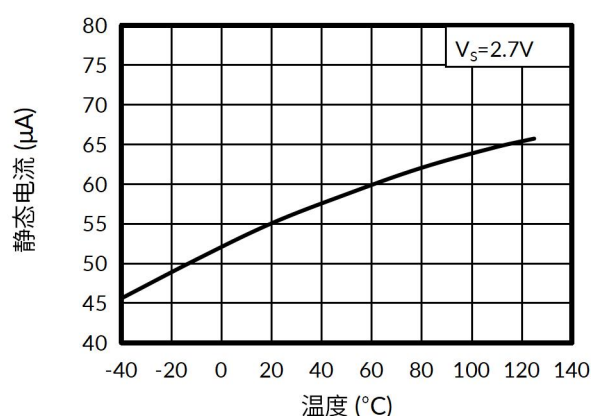


图 6. 静态电流与温度的关系

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

测试条件为: $T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $V_S = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, $V_{\text{OUT}} = V_S/2$ (除非特别注明)。

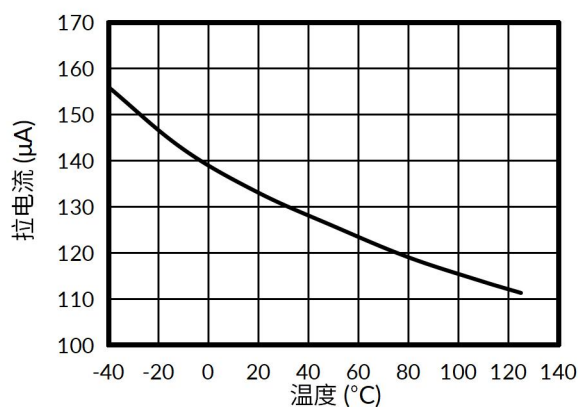


图 8. 拉电流与温度的关系

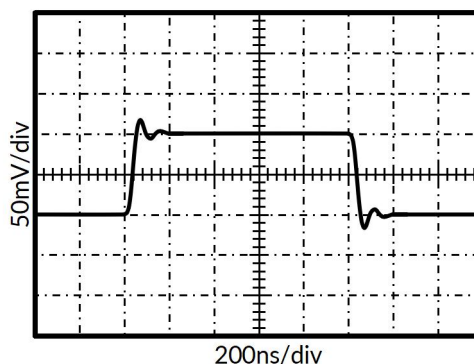


图 10. 小信号阶跃响应

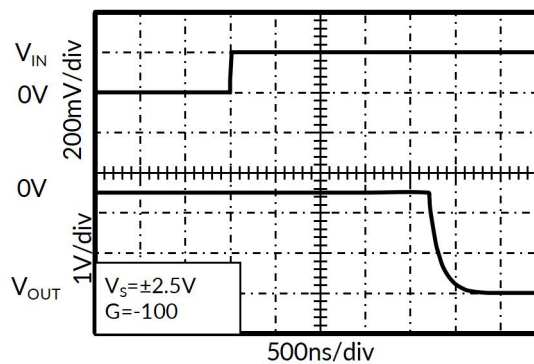


图 12. 正向过载恢复

典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

测试条件为: $T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $V_S = 5\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S/2$, $V_{\text{OUT}} = V_S/2$ (除非特别注明)。

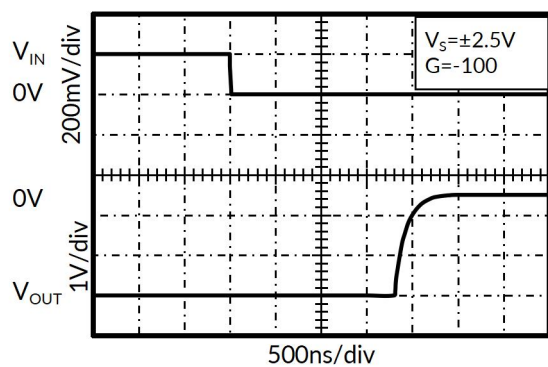


图 13. 反向过载恢复

8 应用与设计

以下应用设计部分中的信息不是 TLXIC 组件规范的一部分，TLXIC 不保证其准确性或完整性。TLXIC 的客户负责确定组件是否适合其用途。客户应验证和测试其设计功能，以确认器件正常工作。

8.1 应用注意事项

TLX358A 是高精度轨到轨运算放大器，在单电源供电条件下，可在 2.5V 至 5.5V ($\pm 1.25\text{V}$ 至 $\pm 2.75\text{V}$) 电压范围内工作。电源电压高于 7V 时（绝对最大值）会永久损坏放大器。轨到轨输出摆幅显著增加了动态范围（特别在低电压供电应用中）。PCB 布局上需要在紧靠电源引脚放置一个 $0.1\mu\text{F}$ 的对地旁路电容。

8.2 PCB 布局设计注意事项

为了使芯片在应用中能充分表现出其性能，请注意 PCB 布局设计的注意事项。尽可能缩短走线，外部原件应尽可能靠近器件摆放。在每个供电脚和接地端之间接入低等效串联电阻 (ESR) 的 $0.1\mu\text{F}$ 陶瓷旁路电容，并尽量靠近器件摆放。

以上事项用于整个模拟电路，可以提高芯片性能并降低 EMI。

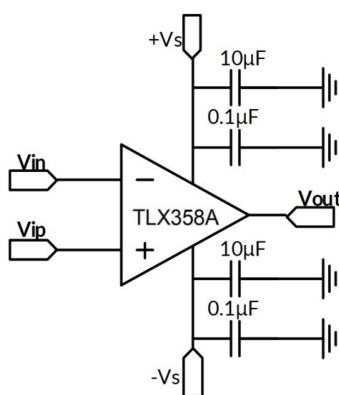


图 14. 带旁路电容器的放大器

8.3 仪表放大器

在三运放中，仪表放大器配置如图 15 所示。

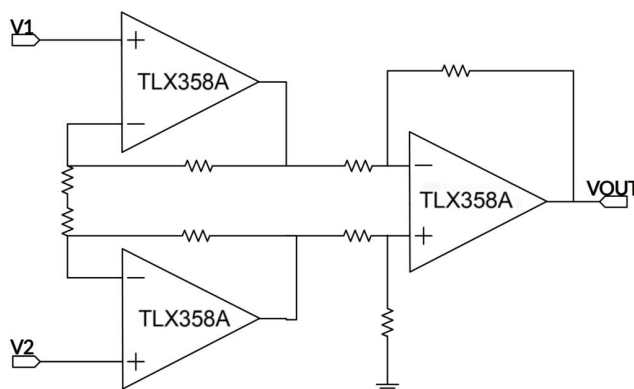


图 15. 仪表放大器

8.4 概览

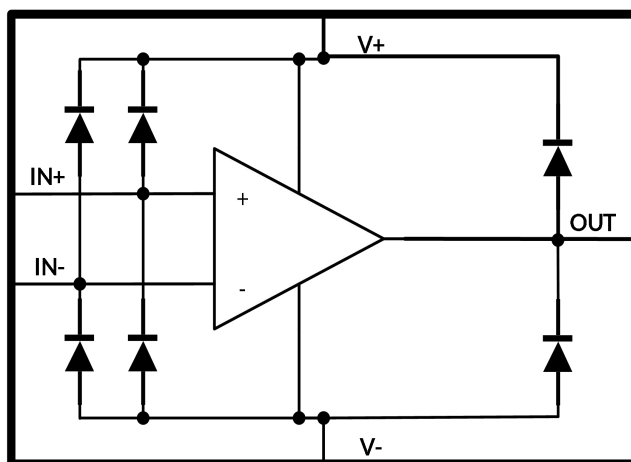
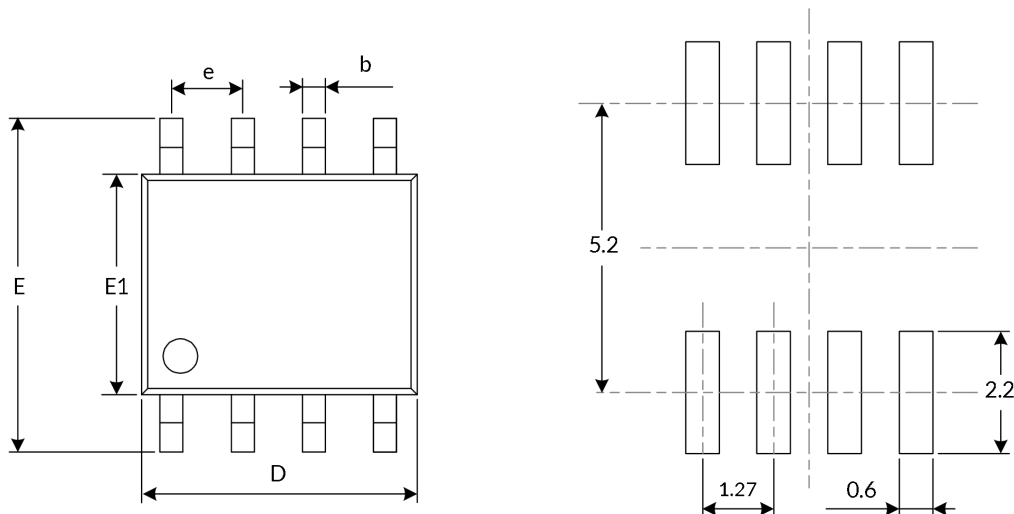
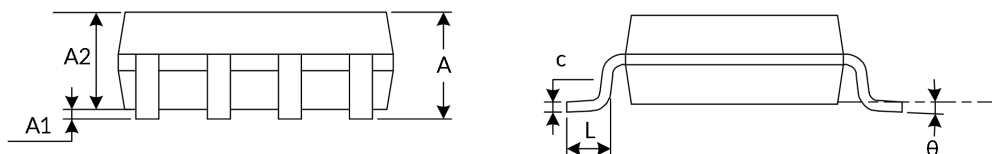


图 16. 功能框图

9 封装规格尺寸

SOP8⁽³⁾

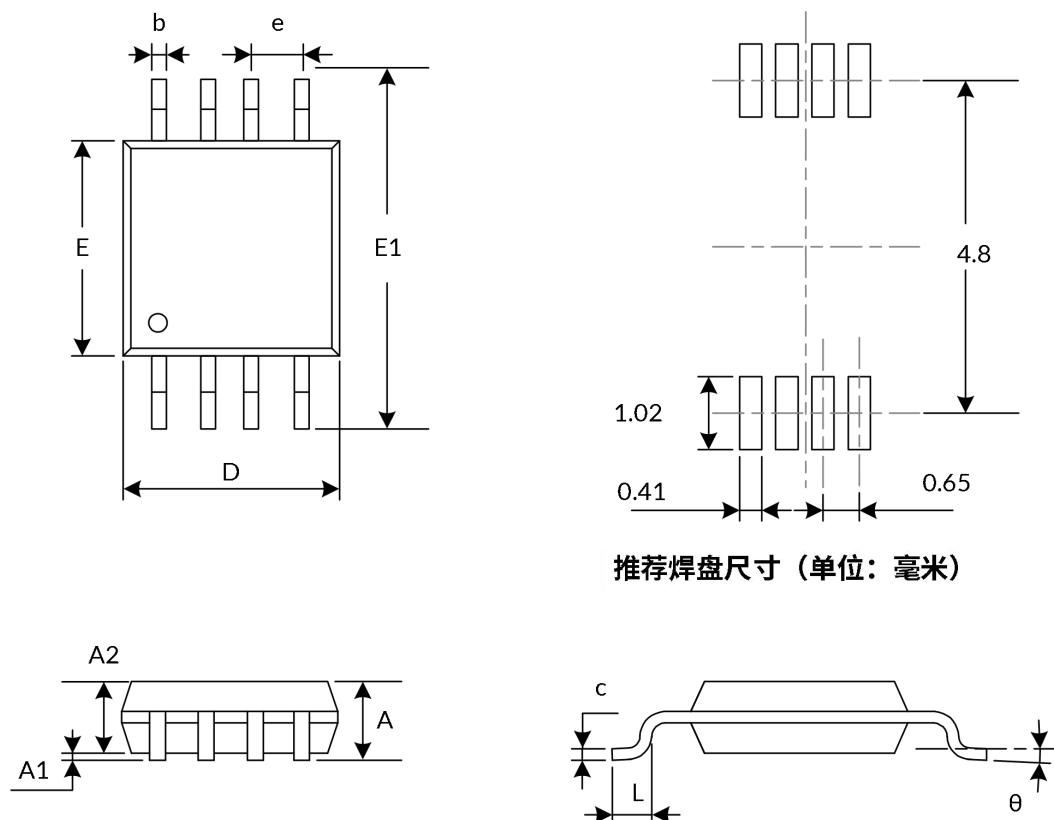
推荐焊盘尺寸 (单位: 毫米)



符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D ⁽¹⁾	4.800	5.000	0.189	0.197
e	1.270(BSC) ⁽²⁾		0.050(BSC) ⁽²⁾	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1 ⁽¹⁾	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

注意:

1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
3. 本图如有更改, 恕不另行通知。

MSOP8⁽³⁾

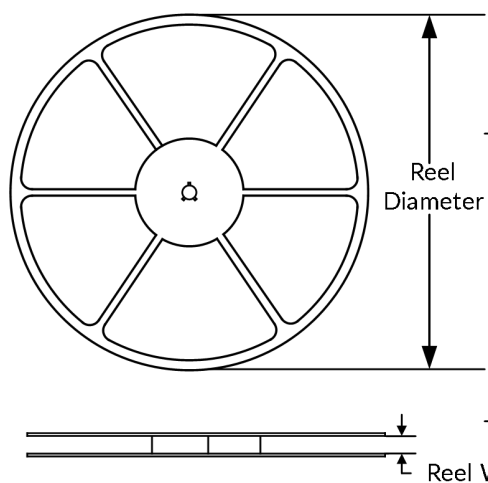
符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
E ⁽¹⁾	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

注意:

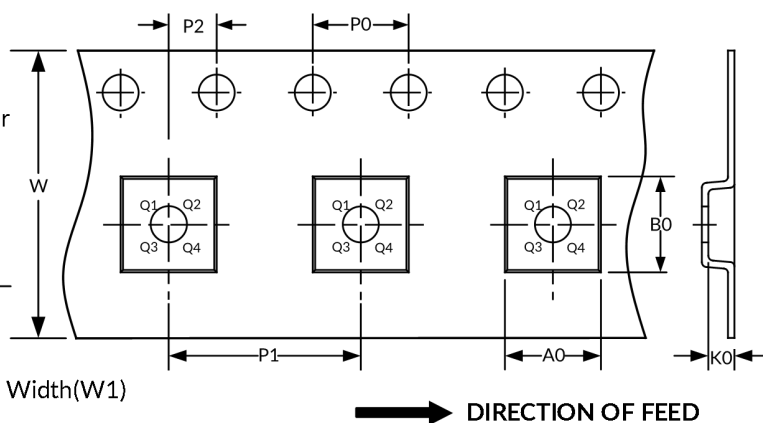
1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
3. 本图如有更改, 恕不另行通知。

10 包装规格尺寸

卷盘尺寸



编带尺寸



注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

关键参数表

Package Type	Reel Diameter	Reel Width (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SOP8	13"	12.4	6.40	5.40	2.10	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1
MSOP8	13"	12.4	5.20	3.30	1.50	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1

注意：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每边最大 0.15 毫米的塑封料或金属突起。